



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЕС13с

Полностью резервируемые системы большого масштаба
с сертифицированной архитектурой безопасности

Основа цифровой
инфраструктуры
и корпоративной
информационной
безопасности.

ОСОБЕННОСТИ:

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мощные процессоры различной специализации, оптимизация под виды нагрузок, быстрое взаимодействие в памяти.

СЕРТИФИКАЦИЯ CC EAL5

Программные системы надёжно изолированы в рамках единой среды безопасности. При необходимости используются защищённые механизмы взаимодействия.

ГИБКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Виртуализация на 2 уровнях и диспетчеризация виртуальных сред.

Универсальная корпоративная платформа, совместимая с открытым программным и аппаратным обеспечением. Поддерживает все популярные сетевые стандарты и протоколы. Лучшая основа для систем, критичных к простоям и потерям данных.

Свяжитесь с нами:

+7 495 540 50 55; sales@yadro.com
Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Посетите сайт:

oem.yadro.com/ec-mainframes/ec13c



ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Горячая замена любых компонентов, включая процессоры. Резервные процессоры с прозрачным переключением при отказе. RAID для памяти и кластеризация до 32 узлов.

СТАНДАРТЫ СЕРВИСА

Гарантированная обработка задач в соответствии с уровнем SLA даже под полной нагрузкой.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Градации мощности «по требованию» и интеллектуальное управление разнородной нагрузкой.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Интегрированные решения, использующие мобильные технологии, облачные сервисы, аналитику и транзакционные компоненты.
- Анализ данных в реальном времени.
- Бизнес-критичные и высоконагруженные транзакционные системы.
- Серверы БД в системах, где данные имеют особую ценность.
- Универсальная корпоративная платформа для консолидации нагрузок.



Форм-фактор	Одиночная стойка
Модули	До 2 процессорных полок До 3 полок ввода/вывода
Управление	Встроенные модули управления с мониторами и клавиатурами.
Процессоры	От 6 до 7 ядер 22 нм, 4.3 ГГц, 64 МБ L3 SMT2, SIMD
Количество ядер на мейнфрейм	До 20 доступных для конфигурирования До 2 резервных
Градация вычислительной мощности	156 уровней
Память	До 4 ТБ установленной памяти, включая системную область 40 ГБ и обеспечение технологии RAIM (RAID для памяти).
Ввод/вывод	До 160 канальных карт PCIe До 6 логических канальных подсистем
Поддержка ввода/вывода	<ul style="list-style-type: none"> • FICON Express 16S / 8S / 8 • OSA-Express 5S / 4S (при наследовании) • 10GbE RoCE Express • Crypto Express 5S • Flash Express • zEDC Express
Горизонтальное масштабирование	До 32 1x HCA3-O LR (IFB LR) До 16 12x HCA3-O (IFB) До 16 ICA SR До 32 IC Максимальное совокупное число соединений на мейнфрейм — 80 шт.
Охлаждение	Воздушное
Электропитание	Однофазное или трехфазное Опциональный верхний ввод Внутренние батареи
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"> • z/OS v1.12 / 1.13 / 2.1 / 2.2 • z/VM v6.2 / 6.3 • z/VSE 5.1 и последующие • z/TPF 1.1 • KVM • RHEL 5 / 6 / 7 • SLES 11 / 11

Россия, 123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13

Тел.: +7 495 540 50 55; Факс: +7 495 540 50 55; e-mail: info@yadro.com

Контактный центр регистрации запросов

Сервисного отдела компании YADRO:

Тел.: +7 495 775 31 22; e-mail: support@yadro.com

